

2016年3月期（平成28年3月期） 第3四半期 決算説明会資料



2016年2月1日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

① 用語の説明

用語	内容
PWB用部材 (Printed Wiring Board)	プリント配線板用部材
FPD用部材 (Flat Panel Display)	フラットパネル・ディスプレイ用部材
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト (レジストインキ)
PKG用部材 (Package)	半導体パッケージ用部材

2

当社グループの製品分野

分野	分類	性状	用途
PWB用 絶縁材料	リジッド	液状	表層保護・絶縁用 SR材料
	PKG/フレキ	液状 /ドライフィルム	
	ビルドアップ	液状 /ドライフィルム	層間絶縁・穴埋め用 ビルドアップ材料
FPD用 導電材料	FPD	液状	タッチパネル・シールド用銀ペースト
その他 関連商材	その他	液状	マーキング・エッチング・めっき用材料 フラックス・溶剤等

1

中外化成株式会社を2015年5月から新規連結

※今期は11ヶ月連結

2

為替は想定レートより円安に推移

※円・USD想定レート:110円

3

中華圏を中心に売上数量の減少

4

**2015年は世界の主要エレクトロニクス製品と
半導体市場はマイナス成長**

出展：みずほ銀行、ガートナー

5

原材料の現地調達化が進み原価率の改善

6

2015年9月北九州工場竣工により、コスト増加

連結業績サマリ

単位：百万円

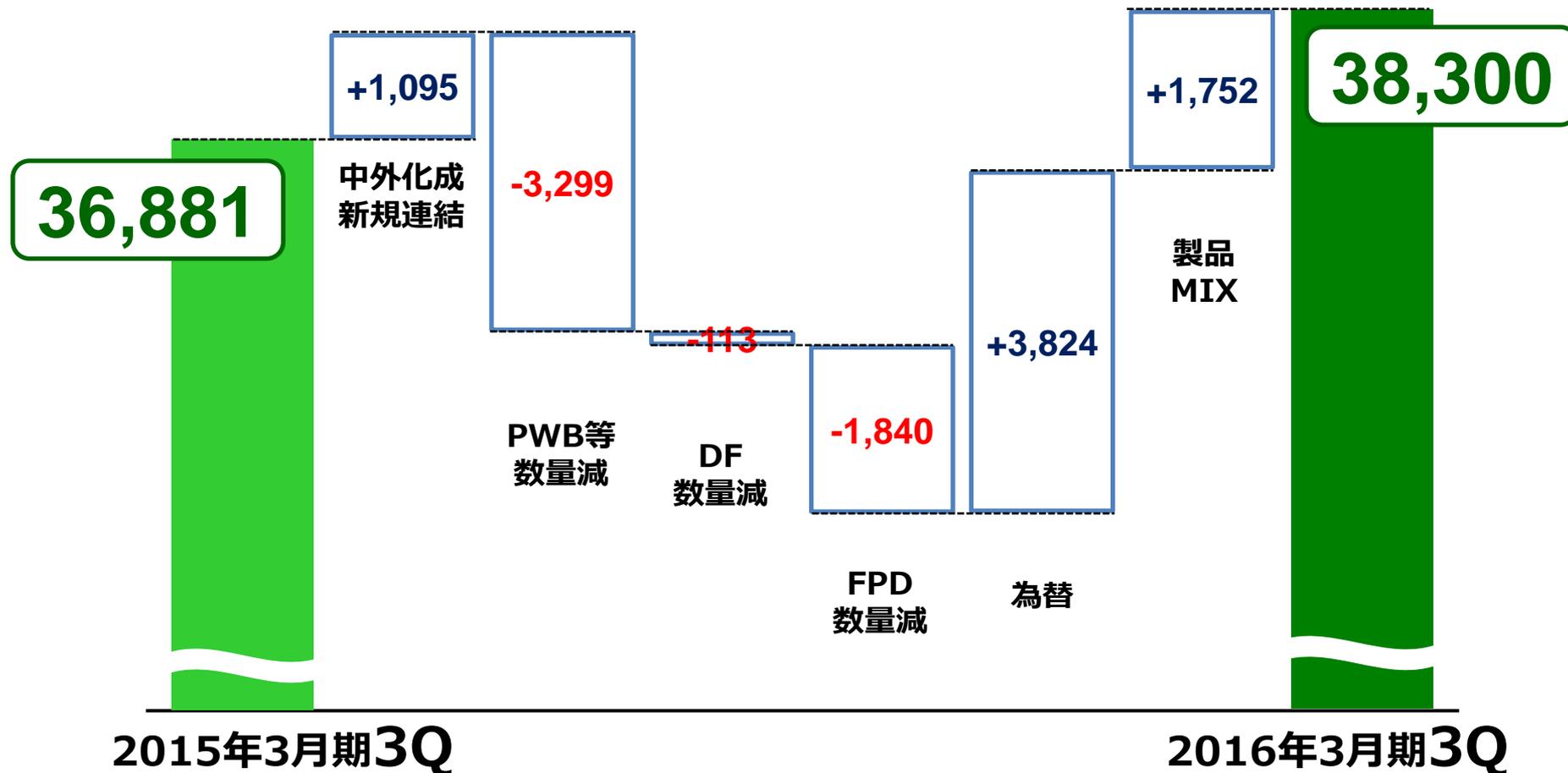
	2015年3月期 第3四半期 累計実績	2016年3月期 第3四半期 累計実績	前期比	増減率	2016年3月期 通期 業績予想	進捗率
売上高	36,881	38,300	+1,419	+4%	51,500	74%
営業利益	7,257	8,646	+1,389	+19%	10,200	85%
経常利益	7,465	8,831	+1,366	+18%	10,300	86%
純利益	5,281	6,226	+945	+18%	7,000	89%
円・USDレート	107.25	121.45	+14.20	+13%	110.00	

5

2016年3月期 第3四半期 売上高（前期比）

売上高前期比分析

単位：百万円

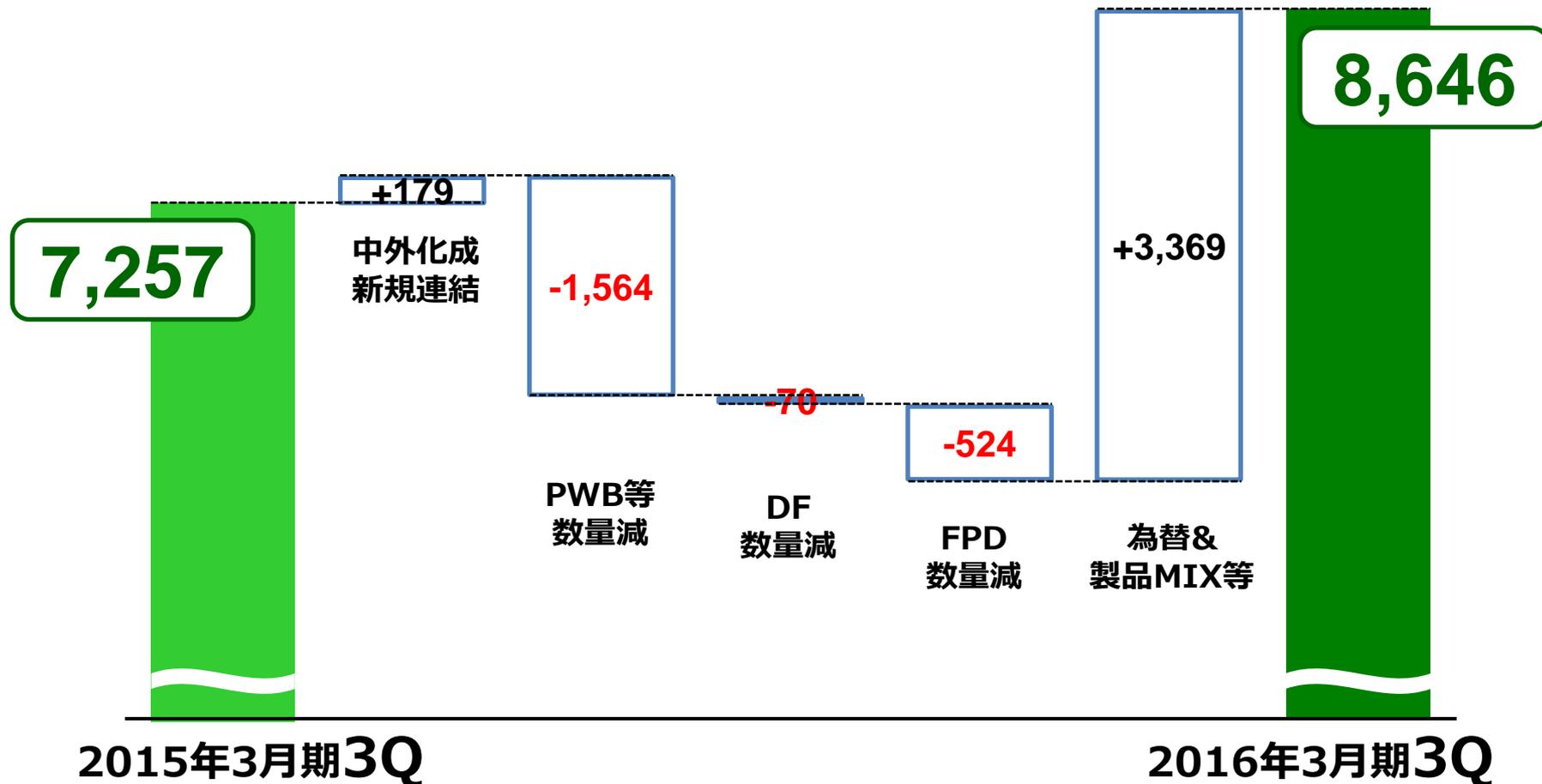


6

2016年3月期 第3四半期 營業利益（前期比）

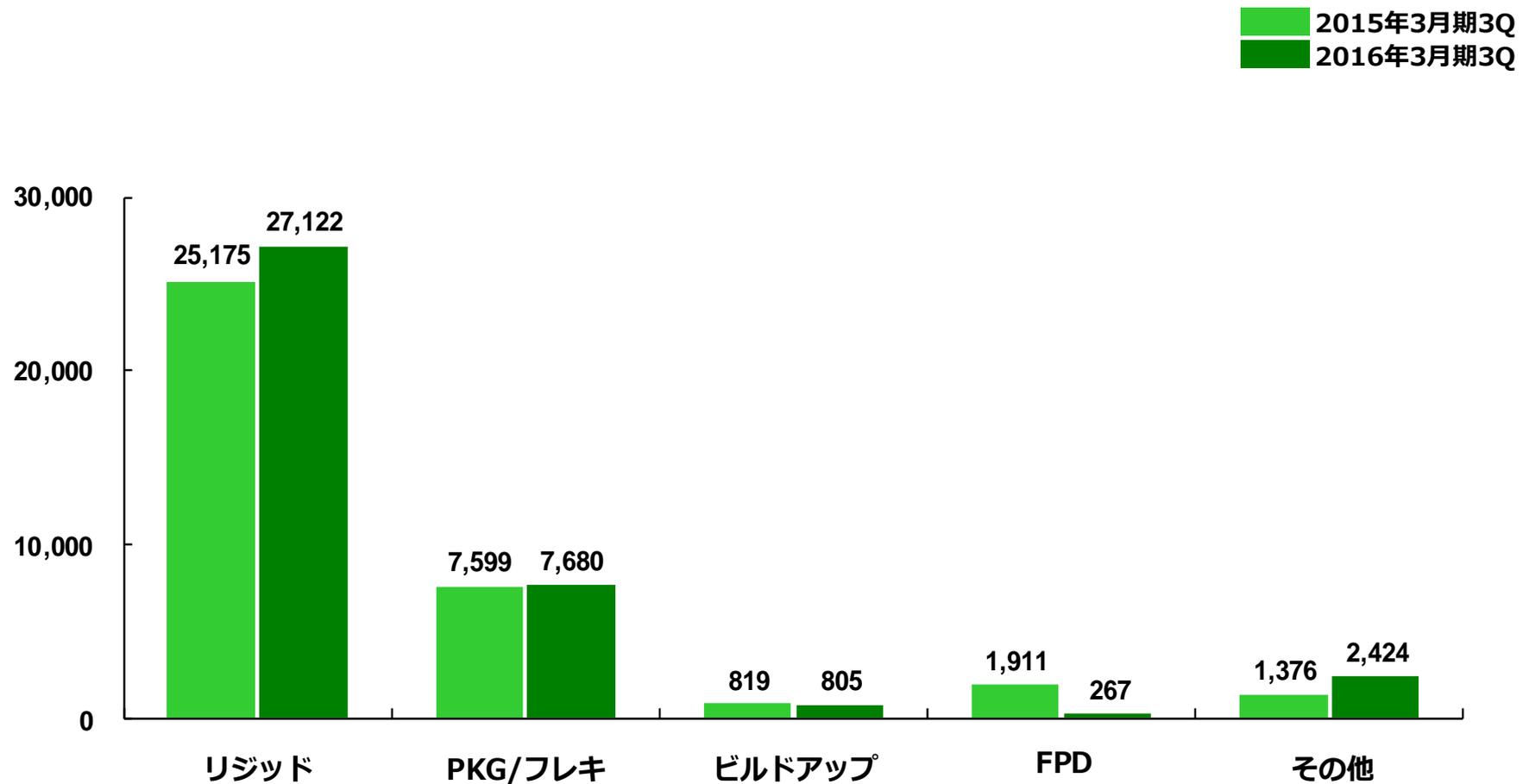
營業利益前期比分析

單位：百万円



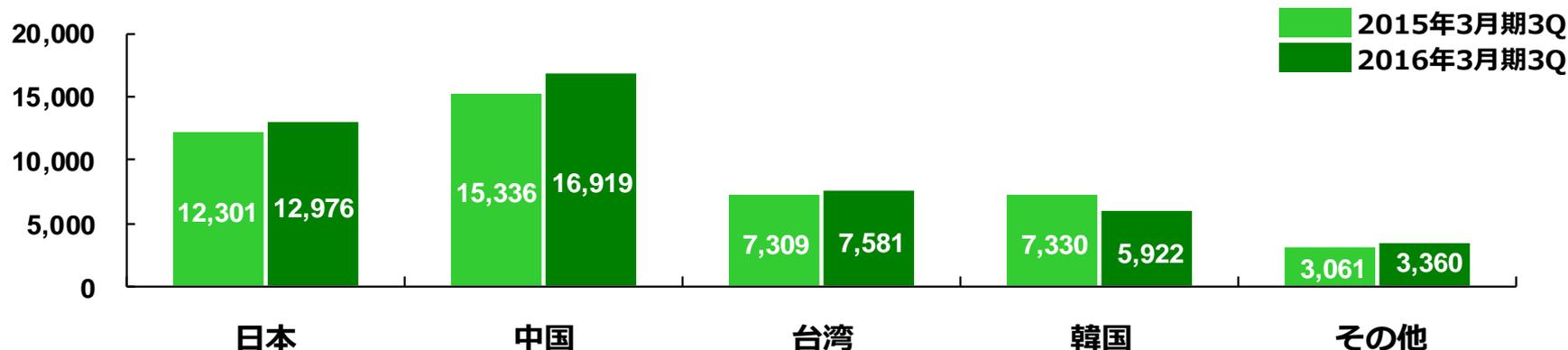
製品区分別売上高

単位：百万円



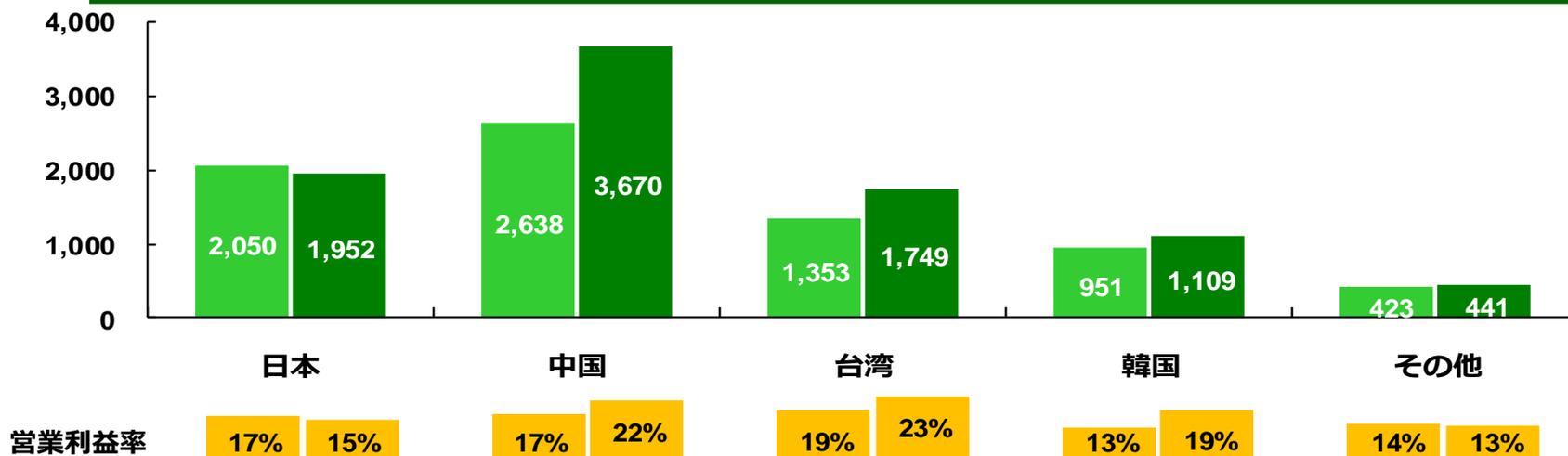
セグメント別：売上高 (グループ内売上含む)

単位：百万円



セグメント別：営業利益 (グループ内売上含む)

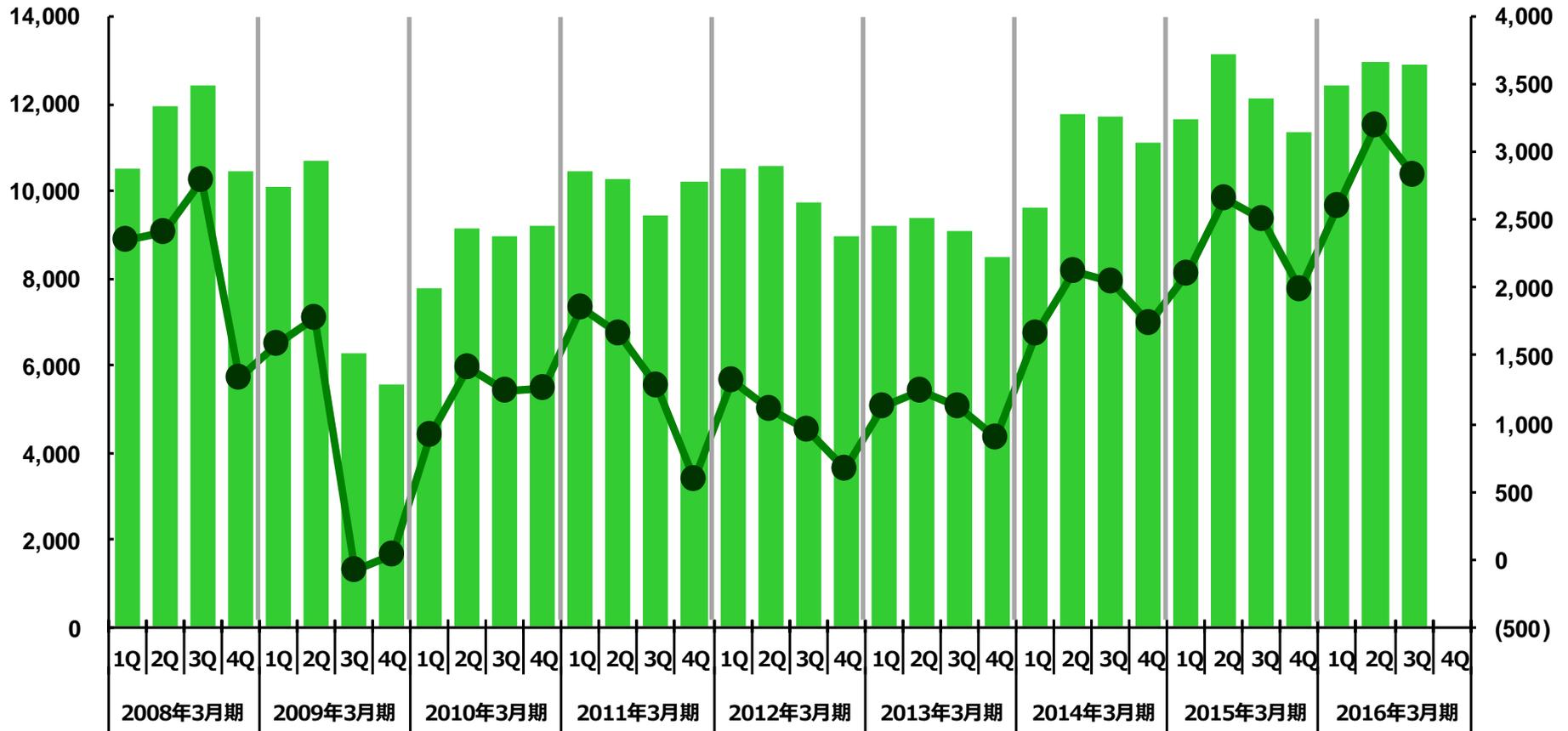
単位：百万円



四半期別推移：売上高/営業利益

単位：百万円

■ 売上高（左軸）
● 営業利益（右軸）





NEXT STAGE - 新たな展開へ -

明日の地球に出来ること
For Tomorrow